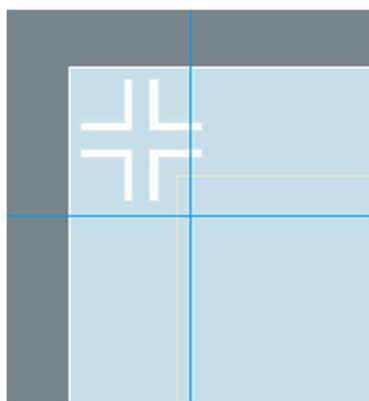


# 位置も、角度も、ズレなく 矩形、異形、孔加工いたします

当社では、ガラス基板上的のアライメントマークをカメラで認識し、基準として高精度な加工を実現しています。加工テーブル上の基板に対し、基準位置と検出位置の誤差を算出し、正確に位置決めを行います。さらに W エッチャーや CNC 端面加工など、保有設備との組み合わせにより多様な一貫加工対応が可能です。試作から量産まで、短納期での対応をお約束します。



Vol. 52



## アライメント加工

### 私達の強み

- \* W エッチャーライン、CNC 端面加工との組み合わせによる一貫プロセスと品質保証
- \* 試作、小ロットから量産まで柔軟に対応いたします



松浪硝子ファインガラスカタログ

## アライメント対応加工装置

### ホイール加工機

「直線加工（矩形）/異形（R 加工）」

対応基板サイズ：Max：730×920 mm

加工位置精度：±50um 最小分解能：0.001 mm



### レーザー加工機

「直線加工（矩形）/異形（R 加工）/孔加工」

対応基板サイズ：Max：730×920 mm

加工位置精度：±50um 最小分解能：0.001 mm



### ウォータージェット加工機

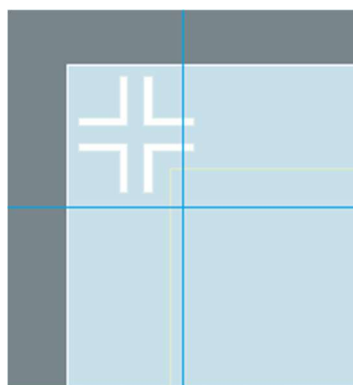
「直線加工（矩形）/異形（R 加工）/孔加工」

対応基板サイズ：Max：500×500 mm

加工位置精度：±200um 最小分解能：0.001 mm



その他の加工・仕様にも対応しますのでご相談ください。  
弊社ではガラス調達～切断・形状加工・コーティングまで  
社内一貫生産で対応可能です。



## Alignment Processing

### Our advantage

- \* Integrated Process and Quality Assurance through the Combination of W-Etcher Line and CNC Edge Processing
- \* We flexibly support everything from prototypes and small-lot production to mass production.



Fine Glass catalogue

**We perform rectangular, irregular shape, and hole processing with precise positioning and angle alignment, without any deviation.**

We use a camera to recognize alignment marks on glass substrates and use them as standards for high-precision processing. The error between the reference position and the detected position is calculated for the substrate on the processing table, and accurate positioning is performed. Furthermore, we can provide various integrated processing services by combining our facilities such as W etching and CNC end-face machining. From prototyping to mass production, we promise quick delivery.

### Alignment-compatible processing equipment

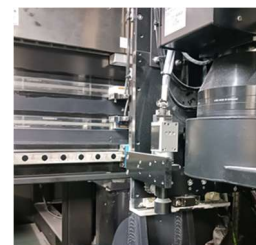
#### Wheel processing machine

Straight line processing (Rectangle)/  
Different shape (R processing)"  
Supported substrate size: Max: 730×920mm  
Processing position accuracy: ±50um  
Minimum resolution: 0.001mm



#### Laser processing machine

"Straight line processing (Rectangle)/  
Odd shape (R processing)/ Hole processing"  
Supported substrate size: Max: 730×920 mm  
Processing position accuracy: ±50um  
Minimum resolution: 0.001 mm



#### Water jet cutting machine

"Straight line processing (Rectangle)/  
Odd shape (R processing)/ Hole processing"  
Applicable substrate size: Max: 500×500mm  
Processing position accuracy: ±200um Minimum resolution: 0.001mm



**We also support other processing methods and specifications, so please feel free to contact us. At our company, we offer fully integrated in-house production—from glass procurement to cutting, shape processing, and coating.**